

WI-6500自动晶圆缺陷检测系统



产品描述

WI-6500由机器视觉检测系统、自动化上下料系统、自动化检测系统、控制软件等组成，支持25个晶圆片（1个晶圆盒）的自动缺陷检测。该系统可检测出晶圆盒中的晶圆数量和位置，并对其位置进行校准，快速检测缺陷、提取缺陷图像，最后生成缺陷图，同时将结果存储在生产线的系统数据库中，供操作人员和工程师分析产品的缺陷情况。

产品特点

- 最小缺陷：0.5 μ m
- 兼容晶圆尺寸：6英寸和8英寸
- 每片晶圆测试时间： \leq 15分钟
- 自动化上下料，每批最多测试量：25pcs
- 洁净等级：百级
- 自动聚焦和分层聚焦图像摄取
- 机器视觉系统自动检测
- 缺陷分析、生成Map报告

产品应用

该系统可自动检测晶圆盒中晶圆上的缺陷，如污点、划痕、凸凹、断裂等，并生成缺陷检测报告。

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，如有疑问，请与我司联系。



| 缺陷检测系统 | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 检测类型 | 明场、暗场 | - |
| 成像类型 | 彩色、黑白 | - |
| 探测放大倍数 | 1.25X、2.5X、5X、10X、20X | - |
| 检测缺陷 | 手动/自动缺陷检测 | - |
| 检测时间 ¹ | ≤15 | min |
| 缺陷检测捕获率 | 99% (>3Pixel) | - |
| 缺陷检测失误差 | 1% | - |
| 复测率 | 1% | - |
| 硅晶片平台 | | |
| 兼容晶圆尺寸 | 6/8 | 英寸 |
| 自动对焦 | 镜头配有Z轴电机，可自动对焦 | - |
| XY和旋转台 | 检测需要XY方向的电机平台，校准需要旋转台 | - |
| 自动加载 | | |
| 物料装载 | 每次装载1个晶圆盒，一个晶圆盒可以装载25片晶圆 | - |
| 预校准 | 在晶圆检测前自动预校准 | - |
| 使用环境 | | |
| 洁净等级 | 百级 | - |
| 环境温度 | 10~45 | °C |
| 环境湿度 | 30~70 | %RH |
| 一般特性 | | |
| 电源 | AC 220V±10% | - |
| 尺寸 | D 1320 * W 1082 * H 2116 | mm |
| 净重 | 648 | Kg |
| 地面承载力 | ≥800 | Kg/m ² |

备注：

1. 每个6英寸晶片的检测时间

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，如有疑问，请与我司联系。

